

BiotTIM TFJ210

产品描述

BiotTIM TFJ210 导热填缝剂提供以下产品特性：

技术	有机硅
化学类型	双组份有机硅
外观(未固化)	光滑，黄色
A组分	浅灰
B组分	黄色
按体积、树脂与硬化剂	1:1
固化条件	室温或加热
应用	导热填缝，热界面材料
使用温度	-60°C到200°C

产品特色和优势

- 高触变性、高点胶速率
- 双组分配方易于存储
- 超低挥发
- 在高低温下，化学及物理性能稳定

典型应用

- 照明灯
- 汽车电子设备（HEV、NEV、电池）
- 对硅挥发比较敏感的精密电子设备

推荐固化时间

固化时间@25°C（小时）：	8
固化时间@100°C（分钟）：	60

未固化材料的典型特性

粘度，ASTM D4287,1s ⁻¹ （混合后，Pa.s）	400
密度，ASTM D792（g/cc）	2.6
操作时间，旋转流变仪（分钟）	30
在架寿命@25°C（月）	6

固化材料的典型特性

邵氏硬度 Shore OO，ASTM D2240，延迟30秒	50
比热容，ASTM D1269（J/g.k）	1.0
阻燃测试，UL94	V-0
硅氧烷含量，ΣD4-D10（ppm）	<100
体积电阻率，ASTM D257（Ω·cm）	1 x 10 ¹⁴
介电强度，ASTM D149（V/mil）	500
导热系数，ASTM D5470（W/m.K）	2.0

使用注意事项

本产品属于加成型有机硅体系，不可使用于含有硫、磷、铵等会影响固化的元素表面，使用前需清洁基材表面。

以上固化简介是指导性建议，固化条件（时间和温度）可能因客户的经验及其应用要求以及客户固化设备、烘箱装载和实际烘箱温度而异。

客户在实际应用前应结合使用情况，在生产前进行试验。

材料说明

BiotTIM 导热填缝剂 TFJ210是一种双组份液体间隙填充导热材料。耐高温、低模量和超低硅氧烷挥发性能，使它能广泛应用于众多电子设备领域。在室温或高温的条件下固化后，它仍具有极佳的传热性能和卓越的柔软度。在固化之前，该材料具有良好的触变性和低粘度。

TFJ210类似凝胶状液体材料的设计，是用来填充空气间隙和空隙，在外力作用下(如分配或装配过程)仍可流动。在填充脆性组件和独特复杂的间隙的时候，它具备的柔软、热传导的弹性体性质，使它成为导热的理想界面间隙材料。

液体点胶导热材料在未固化前可以提供无限的厚度变化，并在组装过程中对敏感部件施加很少或没有应力。TFJ210表现出低水平的粘接特性，用于不需要强结构粘接的应用。

储存方式

将产品储存在干燥的未开封容器中。储存信息会在产品容器标签上注明。

最佳储存温度：不高于25°C。高于25°C的储存会对产品性能产生不利影响。从容器中取出的材料在使用过程中可能受到污染。不要将产品退回原容器。本公司对被污染的产品不承担任何责任，也不对在非先前规定的条件下储存的产品承担任何责任。如果需要其他信息，请联系您当地的技术服务中心或客户服务代表。

可用配置

BiotTIM 导热填缝剂 TFJ210提供以下包装：

- 1200CC双单组份管
 - 400CC双组份管
 - 50CC双组分管
- 或按客户要求定制

免责声明

本技术数据表（TDS）中提供的数据基于本公司实验室测试数据的典型值。TDS中的信息，包括产品使用和应用的建议，都基于我们截至本TDS发布之日的产品知识和经验。产品在您的使用中可以有各种不同的应用以及工作条件，这些应用和工作条件超出了我们的控制范围。因此，本公司无法保证我们的产品适合您使用的生产流程和条件以及预期应用和结果的适用性。我们强烈建议您进行自己的前期试验，以确认我们产品的合适性。